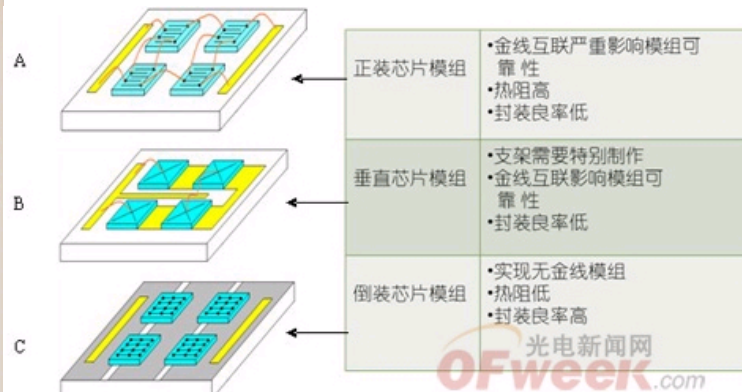


- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意

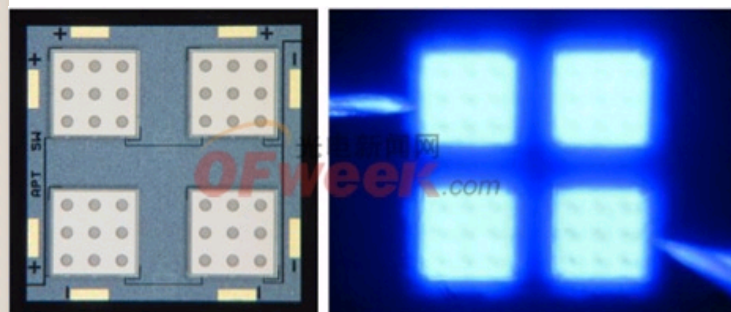
### 晶科电子芯片模组亮度再创新高

2010-02-26 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

据LED业内人士证实,晶科电子(广州)有限公司采用具有自主知识产权的倒装焊技术生产大功率芯片模组(4颗1W芯片倒装而成),芯片尺寸只有3.36x3.36mm<sup>2</sup>,近日又创亮度历史新高。此芯片模组在电压6.6V,电流700mA下测试,白光封装光通量达到422.4lm,光效达到91.4lm/W。现晶科电子已开始批量生产此高亮度芯片模组,并向市场推广,已得到不少客户广泛好评,使LED照明普及事业又向前迈进了一大步,同时使国内芯片技术达到国际领先水平。



晶科电子开发的芯片模组采用倒装焊技术,如上图所示,相对正装结构或垂直结构的LED而言,其实现了无金线互联,具有封装生产良率高,可靠性极好,散热能力强的优点,内置ESD保护电路使其可抵抗高达6000V(HBM)以上的静电,是超大功率芯片光源的最佳选择。



倒装焊大功率芯片模组实物图

(来源: 光电新闻网 2010年2月22日)



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号